

電子部品向けめっき薬品トップシェア

(※当社調べ)

私たちは日本高純度化学です。



世界のエレクトロニクス産業を支えるめっき技術において、リーディングカンパニーであり続ける日本高純度化学。私たちの高品質・高性能な製品は絶え間ない研究開発によって生み出されています。多品種、少量、短納期で出荷できる当社の製造体制はお客様のニーズに確実に応えいたします。



Auめっき液

電解軟質Auめっき液

半導体、プリント基板向けに開発。Au純度99.99%のめっき皮膜が形成可能、ワイヤーボンディング、はんだ付けに優れる。

- テンペレジスト シリーズ
 - シアンタイプ ■ ノーシアンタイプ

電解硬質Auめっき液

コネクタ、プリント基板コネクタ向けに開発。Au純度99.7-99.9%のめっき皮膜が形成可能。接点、はんだ付けに優れる。

- オーロプライト シリーズ
 - シアンタイプ
 - ・ Au-Co合金
 - ・ Au-Ni合金

電解フラッシュAuめっき液

極薄付け用AuめっきとしてAuストライク、リードフレーム向けに開発。

- アシドストライク
 - Auストライク用 シアンタイプ
- アフタープレート
 - リードフレーム用 シアンタイプ

無電解Auめっき液

プリント基板向けに開発。置換フラッシュタイプは、はんだ付け、耐食性に優れる。還元タイプは厚付け可能、ワイヤーボンディングに適する。

- IM-GOLD IBシリーズ
- IM-GOLD CNシリーズ
 - シアン置換タイプ Ni-Pめっき上
- IM-GOLD PC
 - シアン置換タイプ Cu上
- ネオゴールド シリーズ
 - ノーシアン還元タイプ
 - 一次Au (めっき or スパッタ) 上

Pdめっき液

電解Pdめっき液

PPF向け純Pdはワイヤーボンディング、はんだ付けに優れる。コネクタ向けPd-Niは高硬度皮膜が得られる。

- パラプライト シリーズ
 - 純Pdタイプ ■ Pd-Ni合金タイプ

無電解Pdめっき液

プリント基板向けに開発。ENEPIGプロセスに利用することでワイヤーボンディング、はんだ付けに優れる。

- ネオパラプライト シリーズ
 - 純Pdタイプ

Agめっき液

電解Agめっき液

リードフレーム向けに開発。ワイヤーボンディング、はんだ付けに優れる。

- テンペレジスト AGRシリーズ
- セレナプライト シリーズ
 - シアンタイプ

無電解Agめっき液

プリント基板向けに開発。はんだ付けに優れる。

- IM-SILVER TK
 - ノーシアン置換タイプ Cu上

その他

抗菌剤

めっき液、回収槽へ添加しても性能低下なく、めっき皮膜へ影響を与えない抗菌剤。

- MFP抗菌剤シリーズ

Cu除去樹脂

Cuを選択的に除去可能な樹脂。浴更新頻度を下げてコスト低減に寄与。

- JPR 2001

活性炭フィルター

特殊活性炭繊維を採用。めっき液中の有機不純物除去。

- UPT065-L1 (10インチ)

 日本高純度化学株式会社

〒179-0081 東京都練馬区北町三丁目10番18号
TEL 03-3550-1048(代表) FAX 03-3550-1006

<https://www.netjpc.com>

日本高純度化学

検索

